

令和元年6月8日

ISAPP2019 国際シンポジウム開催のお知らせ “International Symposium on Advanced Power Packaging”

[URL:http://www.isapp.jp/](http://www.isapp.jp/)

皆様

平素より大変お世話になり、誠に有り難うございます。

“International Symposium on Advanced Power Packaging”を本年 10 月 7, 8 日の両日に開催することになりましたので、以下にお知らせ致します。関係する皆様の振るってのご参加をお待ち致します。

【開催の趣旨】

SiC、GaN に代表されるワイドバンドギャップ (WBG) ・パワー半導体は、電力変換に於いて省エネルギー、高周波・小型化、ハイパワー化を実現するデバイスとして、既に世界市場で実用化が開始されている。その適用範囲は、全ての発電や送電、自動車、列車、航空機やドローン、あるいは、船舶などの全て電動移動体、通信インフラやエッジデバイスまでの IoT 機器、家庭やオフィスの機器、さらには、生産現場や各種ロボットに至り、今後の全ての電子・電器制御の要になると期待されている。市場の拡大成長のために解決が必要な大きな技術課題として、耐熱実装がある。本会議は、世界で唯一の会議として WBG 実装技術に焦点を当て、各種課題に対する技術の進展と今後の予測を世界の各分野先端研究者が集い議論を交わす。

【トピックス】

- ◆ 実装材料
高温はんだ、焼結接合材料、TLP 接合、リボン・ワイヤボンディング、DBC/DBA 基板、有機基板、モールド・ポッティング材料、コーティング・めっき、洗浄、熱伝導材料 (TIM) 等
- ◆ プロセス技術・装置
加圧・無加圧ダイアタッチプロセス、リボン・ワイヤボンディング装置、モールド装置、ペースト印刷機、めっき・コーティング装置、表面処理装置等
- ◆ 受動部品
キャパシタ、抵抗器、軟磁性材料・リアクトル等
- ◆ 特性評価方法とデザイン・シミュレーション
熱特性評価方法、熱制御技術、クーリングシステム、電気特性評価法、信頼性評価方法 (パワーサイクル、温度サイクル、高温・高湿放置)、腐食試験、組織評価方法、非破壊検査、ノイズ対策、シミュレーション技術 (設計、寿命評価) 等

【発表申し込み】

概要締め切り : 2019/6/15
論文投稿 (4 頁) : 2019/9/5
ポスター技術展示 : 2019/9/5

【参加費】 (ポスター展示、スポンサーは office@isapp.jp までお問い合わせください)

	発表者	早期申し込み(8/16まで)	当日
一般参加	30,000 円	30,000 円	50,000 円
学生参加	5,000 円	5,000 円	10,000 円

【参加申し込み】

早期登録：2019/8/16

投稿先：<https://isapp.jp/submission.html>

問い合わせ先：

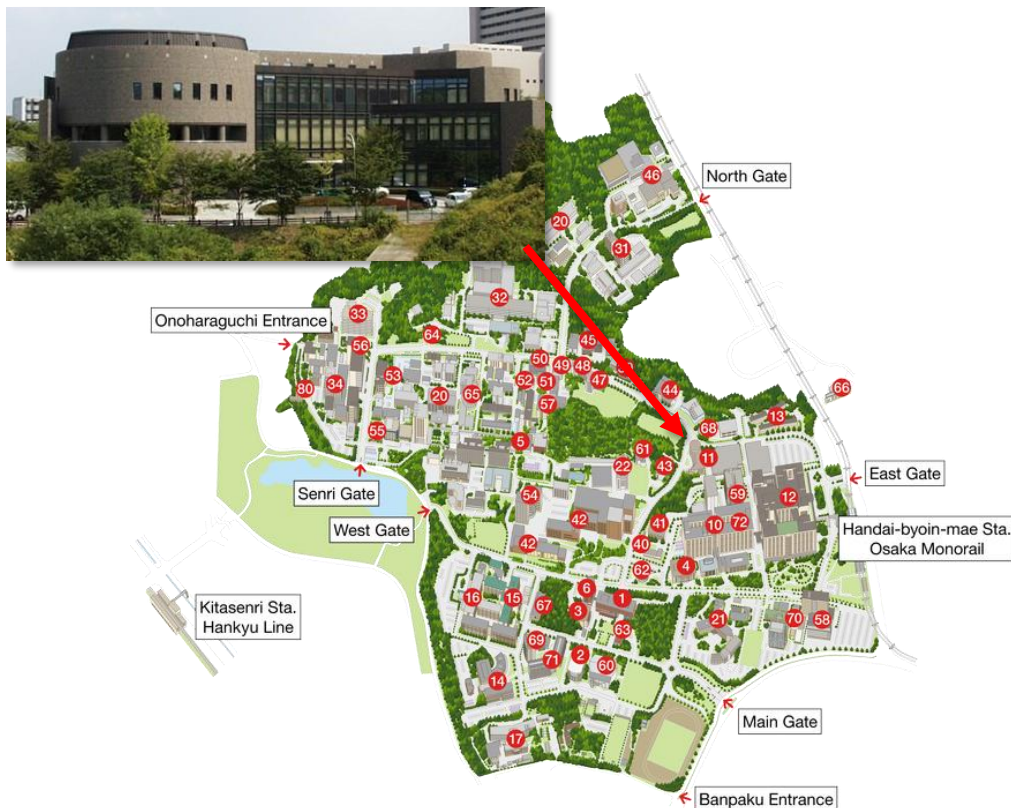
大阪大学 産業科学研究所 菅沼克昭

大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1

電話：06-6879-8520, FAX：06-6879-8522

[E-mail:office@isapp.jp](mailto:office@isapp.jp)

【開催場所】〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2 阪大吹田キャンパス 銀杏会館



最寄り駅：大阪モノレール 阪大病院前

バス：阪急バス・近鉄バス 阪大本部前

タクシー：北千里駅から10分、地下鉄千里中央・JR茨木から15分程度

(<http://www.office.med.osaka-u.ac.jp/icho/accessmap.html>)

【主催組織】

大阪大学産業科学研究所先端実装研究分野

一般財団法人産業科学研究協会 先端パワーエレクトロニクス実装コンソーシアム

【後援組織】

一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA)

一般社団法人 日本ファインセラミックス協会 (JFCA)

一般社団法人 日本電子回路工業会 (JPCA)

一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

一般財団法人 産業科学研究協会 (RAIS)

運営組織

組織委員会

Katsuaki Suganuma (Osaka Univ, Japan)
Tsuyoshi Funaki (Osaka Univ, Japan)
Hiroshi Nishikawa (Osaka Univ, Japan)
Miyuki Harada (Kansai Univ, Japan)
Kiyoshi Hirao (AIST, Japan)
Junichi Murai (Mitsubishi Electric)
Takashi Nakamura (Osaka Univ, Japan)
Keiko Otsuka (ORIST, Japan)
Toshiro Sato (Shinshu Univ, Japan)
Keiji Toda (Toyota, Japan)
Kazuhiro Tsuruta (DENSO CORP, Japan)
Tetsuzo Ueda (Panasonic, Japan)
Kimihiro Yamanaka (Chukyo Univ, Japan)
Hiroshi Yamaguchi (AIST, Japan)

General Chair
Program Chair
Program Co-chair

国際アドバイザー

Alberto Castellazzi (Univ Nottingham, UK)
Tao-Chih Chang (ITRI, Taiwan)
Thomas Harder (ECPE, Germany)
Won Sik Hong (KETI, Korea)
Francesco Iannuzzo (Aalborg Univ, Denmark)
Nando Kaminski (Univ Bremen, Germany)
Leo Lorenz (ECPE, Germany)
Guo-Quan Lu (Virginia Tech, US)
Josef Lutz (Chemnitz Univ, Germany)
Yu-Feng Qiu (SGRI, China)
Andreas Schletz (Fraunhofer IISB, Germany)
Douglas C Hopkins (North Carolina State Univ, US)

プログラム委員会

Katsuaki Suganuma (Osaka Univ, JP)
Hideharu Sugihara (Osaka Univ, JP)
Hiroshi Nishikawa (Osaka Univ, JP)
Kimihiro Yamanaka (Chukyo Univ, JP)
Kiyoshi Kanie (Tohoku Univ., JP)
Ichihito Narita (Osaka Kyoiku Univ, JP)
Takuya Kadoguchi (Toyota, JP)
Kazuhiko Sugiura (DENSO CORP, JP)
Goro Izuta (Mitsubishi Electric, JP)
Tomoaki Hara (Siemens, JP)
Yukinori Oda (C. Uyemura, JP)
Ichiro Ota (Showa Denko, JP)
Minoru Ueshima (Daicel, JP)
Yuichi Aoki (ESPEC, JP)

Kazutaka Takeshita (Yamato Scientific, JP)
Hikaru Nomura (Senju Metal, JP)
Shijo Nagao (Osaka Univ, JP)
Chuantong Chen (Osaka Univ, JP)
Toru Sugahara (Osaka Univ, JP)